



行业动态  
Industry News



### 三星、Hynix合作建立450mm晶圆工艺标准

2008-07-07 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

南韩半导体制造商三星电子Samsung与海力士Hynix日前发表联合报告,将建立合作联盟,共同致力于450mm晶圆开发。这次合作是同Sematech和SEMI开展的建立450mm晶圆标准工作同时进行的。三星与海力士表示,共同发展下一代的内存芯片,希望藉此分摊研发工本,节省未来的专利授权费用,以对抗日本对手重新主宰半导体市场的野心,力保南韩在全球记忆体市场的龙头地位。这种称为自旋力矩转移磁阻随存内存(STT-MRAM)的芯片,有潜质成为下一代的主流内存。南韩政府因此出面协调,促成三星与海力士协作。

南韩知识经济部长李允镐说,这将使南韩半导体产业继续保持领先,在下一代的芯片开发中获取先机。他说:“正当我们的半导体产业面临外国威胁时,我乐见他们在技术上结盟。”日本东芝、NEC与富士通先前已组成开发STT-MRAM的联盟,将在2006-2010年间支出30亿日圆(2,830亿美元)的研发费用。李允镐说,三星与海力士的协作可以把关键技术留在南韩手中,避免日后对外国业者支付庞大授权费用。由于缺乏DRAM与NAND快闪内存的关键专利,南韩芯片业者当前每年必须向东芝、英特尔等公司支付数亿美元的专利权金。

这也是南韩半导体业者集成结盟计划的一环。南韩官员表示,这项协作将使三星与海力士成为18寸晶圆厂的标准制订者。两家芯片厂承诺将采购更多南韩当地生产的晶圆材料、组件与设备。

来源: 半导体国际

2008年6月26日

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意